证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-049

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022 年 9 月 19 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 19 日

至 2022 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金数量及投向	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行方案的有效期	√
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》	√
5	《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√
7	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	√
10	审议《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2022 年 9 月 1 日经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688630	芯碁微装	2022/9/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 9 月 16 日 9:00-11:30，13:30-17:00

（二）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在 2021 年 9 月 16 日 17:00 前送达，传真号：0551-63822005。

（三）登记地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼证券部

（四）登记手续：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请确保个人近期无中高风险地区旅居史，并请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，请股东、股东代理人出示健康码（绿码）、行程码、携带 48 小时有效的核酸检测证明、相关证件、佩戴口罩，在测温正常条件下提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通讯地址：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼证券部

邮编：230000

电话：0551-63826207

电子邮箱：yzwei@cfmee.cn

联系人：魏永珍

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥芯碁微电子装备股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 19 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金数量及投向			
2.08	滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行方案的有效期			
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》			
5	《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》			
6	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》			
7	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
8	《关于公司<未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划>的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》			
10	审议《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-048

合肥芯碁微电子装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称本公司或公司)对截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]350 号)同意注册，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,020.2448 万股，每股发行价为 15.23 元，应募集资金总额为人民币 45,998.33 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,362.51 万元后，实际募集资金净额为 41,635.82 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月 29 日到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0034 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 15,482.82 万元，其中使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 15,000.05 万元(包含东证银行(中国)有限公司合肥分行的募集资金理财产品专用结算账户里期末尚未转回至募集资金专项账户的利息 0.05 万元)，募集资金专户余额 482.77 万元。募集资金存储情况具体明细列示如下：

单位：元

银行账户名称	银行账号	2022 年 6 月 30 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800002478	3,717,724.23	
中国农业银行股份有限公司合肥分行	12187001040099999	399,491.65	
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011000711239	710,445.88	
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001009365	90,000,000.00	大额存单
东亚银行(中国)有限公司合肥分行	149000252760400	60,000,500.00	结构性存款，该账户含有期末尚未转回至募集资金专项账户的利息金额 500 元
合计		154,828,161.76	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况说明

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“高端 PCB 激光直接成像(LDI)设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司将该项目节余募集资金 6,849.44 万元(包含利息收入扣除银行手续费后净额 437.92 万元)永久性补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已对该募集资金专户办理注销手续，本次变更用途的募集资金占前次募集资金总额的比例为 15.40%。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

募集资金投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额(1)	实际投资总额(2)	差异（3）=(1)-(2)	差异原因
高端 PCB 激光直接成像(LDI)设备升级迭代项目	20,770.00	20,770.00	14,358.48	6,411.52	公司在保证项目建设质量的前提下，结合实际情况，节约了部分设备采购投入；同时加强项目实施管控，合理降低了项目投入金额。目前该项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
品圆投封装(WLP)直写光刻设备产业化项目	9,380.00	5,880.00	1,019.05	4,860.95	该项目仍处于建设期
平板显示(FPD)光刻设备研发项目	10,836.00	8,630.82	4,469.85	4,160.97	该项目仍处于建设期
微纳制造技术研发中心建设项目	6,355.00	6,355.00	454.82	5,900.18	该项目仍处于建设期
合计	47,341.00	41,635.82	20,302.20	21,333.62	—

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2021 年 6 月 15 日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,884.91 万元置换预先投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2021 年 5 月 14 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

2022 年 4 月 27 日，经第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议，使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 15,000.00 万元，公司使用闲置募集资金已购买未到期的理财产品的情况如下：

存放银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	CA12836 单位大额存单 G128 期 3 年	大额存单	5,000.00	2021.5.21-2024.5.21
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	单位大额存单新客 G07 期 3 年-CA22NG0736	大额存单	4,000.00	2022.2.25-2025.2.25
东亚银行(中国)有限公司合肥分行	澳元/美元双区间单层触及结构性存款	结构性存款	6,000.00	2022.5.27-2022.8.17
合计			15,000.00	

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“平板显示(FPD)光刻设备研发项目”有助于为公司未来的 OLED 高端产线直写光刻设备产业化打下坚实的基础，提高公司综合竞争力；“微纳制造技术研发中心建设项目”有助于公司对现有技术研发平台进行全面升级，改善公司的研发环境，公司的综合研发实力将得到进一步提升，上述两个项目产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日

附件：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：41,635.82					已累计使用募集资金总额：20,302.20					
变更用途的募集资金总额：6,411.52					各年度使用募集资金总额：20,302.20					
变更用途的募集资金总额比例：15.40%					2021 年：14,830.68 2022 年 1-6 月：5,471.52					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高端 PCB 激光直接成像(LDI)设备升级迭代项目	高端 PCB 激光直接成像(LDI)设备升级迭代项目	20,770.00	20,770.00	14,358.48	20,770.00	20,770.00	14,358.48	6,411.52	2022 年 2 月
2	品圆投封装(WLP)直写光刻设备产业化项目	品圆投封装(WLP)直写光刻设备产业化项目	9,380.00	5,880.00	1,019.05	9,380.00	5,880.00	1,019.05	4,860.95	2023 年 2 月
3	平板显示(FPD)光刻设备研发项目	平板显示(FPD)光刻设备研发项目	10,836.00	8,630.82	4,469.85	10,836.00	8,630.82	4,469.85	4,160.97	2023 年 2 月

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-047

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 1 日分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2022 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-046

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，芯碁微装对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：

一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算

（一）测算假设及前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行股份数量上限为 3,624.00 万股(含本数)(最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准)。若公司在本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应调整。

3、假设公司于 2022 年未完成本次发行。

4、根据公司披露的 2021 年度报告，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 86,726,368.67 元。根据谨慎性原则，假设 2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的预测净利润较 2021 年增长 10%、增长 20%、增长 30%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。

7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	
		发行前	发行后
总股本(万股)	12,080.00	12,080.00	15,704.00
假设 1：假设公司 2022 年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股东的净利润较 2021 年度增长 10%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	8,672.64	9,539.90	9,539.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.77	0.79	0.77
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.77	0.79	0.77
假设 2：假设公司 2022 年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股东的净利润较 2021 年度增长 20%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	8,672.64	10,407.16	10,407.16
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.77	0.86	0.84
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.77	0.86	0.84
假设 3：假设公司 2022 年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股东的净利润较 2021 年度增长 30%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	8,672.64	11,274.43	11,274.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.77	0.93	0.91
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.77	0.93	0.91

注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构，提高行业地位，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。

关于本次向特定对象发行必要性和合理性论述的具体内容，参见本次发行的预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司深耕直写光刻领域，聚焦以微纳直写光刻为技术核心的直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务，产品功能涵盖微米到纳米的多领域光刻环节，是国内专业的直写光刻设备和服务供应商。目前已为泛半导体及 PCB 客户提供性能优良、性价比高的先进直写光刻设备及综合解决方案，整体技术及产业化能力处于行业先进水平。

本次发行所涉及的募投项目包括直写光刻设备产业应用深化拓展项目，IC 载板、类载板直写光刻设备产业化项目以及关键子系统、核心零部件自主研发项目，上述募投项目紧密围绕公司主营业务，是现有主营业务的延伸与拓展，符合公司长期发展规划及业务布局，顺应行业市场发展方向，与公司现有主营业务的发展具有较高的关联度。

本次募投项目的实施将进一步提升公司的市场竞争力，能够有效提高公司的主营业务收入规模及利润水平，巩固并进一步提升公司行业竞争地位，实现公司的长期可持续发展。

（二）募投项目在人员、技术、市场等方面的储备

1、人员储备

芯碁微装是技术创新驱动型公司，通过内部培养和外部引进的方式形成了深厚的人才储备，组建了一支高素质、经验丰富的技术研发团队，截至 2022 年 6 月末，公司技术研发团队共有 187 人，占员工总人数超过 40%。公司科学家团队具备三十年以上半导体设备开发经验，曾任职于赛司、科天半导体、球半导体等全球半导体知名厂商，具有深厚的专业背景及产业积累，多人入选“安徽省创新创业领军人才”、“安徽省百人计划引进人才”和“合肥市领军人才”等高端人才计划，并带领团队获得“安徽省高层次科技人才团队”、“2019 年‘创客中国’安徽省中小企业创新创业大赛企业组一等奖”、“第八届中国创新创业大赛安徽赛区成长企业组二等奖”、“2018 年度合肥高新区优秀企业创新创业奖-专业创造奖”、“庐州产业创新团队”、“江淮硅谷创新创业团队”等荣誉。

未来，公司拟进一步加大研发投入，并持续引入直写光刻领域高层次人才，不断扩充公司研发团队规模，进一步提升研发团队综合能力与水平，为公司本次募集资金投资项目储备充足的人才。

2、技术储备

公司自成立以来，坚持自主创新，注重核心技术成果的保护。公司研发团队通过持续的自主研发和合作研发，在微纳直写光刻核心技术领域积累了丰富的技术成果，现已形成了较为完善的核心技术体系，涵盖系统集成技术、光刻胶外光学及光源技术、高精度高速实时自动对焦技术等 8 大核心技术，并形成了相应的发明专利和软件著作权体系。截至 2022 年 6 月末，公司累计获得授权专利 120 项，包括已授权发明专利 51 项，已授权实用新型专利 64 项，已授权外观设计专利 5 项，拥有软件著作权 14 项。此外，公司在产学研合作领域积极与西安交通大学、安徽工业大学等知名高校建立了合作关系，针对微纳光刻技术领域展开技术合作研发，并建立了联合实验室及人才培养基地，为公司未来的技术创新提供了有效支持。

公司目前已建立起较为完善的核心技术体系与技术成果保护制度，并形成了自主研发、设计、生产的完整技术成果转化体系，推动公司技术实现产业转化。因此，公司丰富的技术储备和出色的技术转化能力，为项目的实施提供了技术支撑。

3、市场储备

凭借突出的产品性能和良好的产品服务，公司自主研发的直写光刻设备得到了下游市场的广泛认可，积累了大量全球高质量泛半导体和 PCB 厂商客户，与其建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户粘性。

依靠领先的技术水平、稳定的产品质量，在泛半导体领域，公司积累了维信诺、辰显光电、佛智芯、矽迈微、生捷电子、立德半导体、华芯中源、泽丰半导体、亘今精密等产业化客户；在 PCB 领域，公司积累了健鼎科技、深南电路、鹏翔控股、景旺电子、TTM 集团等一系列全球 PCB 百强客户。截止 2022 年 6 月末，公司直写光刻设备的总装机量超过了 700 台，具有丰富的产业化应用经验。通过与上述知名客户的合作，公司积累了较高的品牌、市场知名度，具有较强的示范效应，有助于公司进一步拓展潜在客户，具备良好的市场基础。

综上所述，公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

五、填补即期回报被摊薄的具体措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报。同时，公司郑重提示广大投资者，公司制定了以下填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。

（二）加强经营管理，提升经营效益

本次发行募集资金到位后，公司将继续提高内部运营管理水平，持续优化业务流程和内部控制制度，降低公司运营成本，提升公司资产运营效率。此外，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，激发全体公司员工的工作积极性和创造力。通过上述举措，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营效益。

（三）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制

公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，公司现已制定了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。本次向特定对象发行股票后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和最新三年回报规划，保障投资者的利益。

六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等文件的要求，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺：

（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司的全体董事、高级管理人员作出承诺如下：

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

5、本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、若公司未来实施股权激励计划，本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

程章作为公司控股股东及实际控制人，作出承诺如下：

“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

合肥亚歌半导体科技合伙企业(有限合伙)、合肥纳光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及合肥合光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)作为公司实际控制人的一致行动人，作出承诺如下：

“1、本单位承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承